

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2022-049

苏州金宏气体股份有限公司 变更部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：发展与科技储备资金（以下简称“原项目”）

● 新项目名称：全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目/北方集成电路技术创新中心大宗气站项目

● 项目总投资：原项目总投资69,000.00万元，拟使用募集资金投资金额：163,800万元

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：金椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目建设期共计18个月，预计2024年达到使用状态；北方集成电路技术创新中心大宗气站项目建设期共计12个月，预计2023年达

到使用状态。

● 变更募集资金投资项目的原因

根据中国证监会监督委员会于2020年6月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]941号），公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)12,108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,496.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币175,951.06万元，截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验审，于2020年6月11日出具了《容诚字[2020]23020085号》的《验资报告》。具体内容详见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司发展战略及实际情况，公司拟将募集资金投资项目之一的“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目/北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”及“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”，拟将募集资金投资项目之“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目/北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及北方芯能半导体有限公司电子大宗气站项目（以下简称“新项目”），项目总投资69,000.00万元，使用募集资金金额为60,000.00万元，已经使用募集资金25,163,800万元，占总募集资金69,000.00万元的比例为45.2%。

新项目总投资金额90,000.00万元，拟使用原项目剩余的募集资金34,163,800万元。本次变更募集资金投资项目（以下简称“拟变更项目”）的事项不构成关联交易。

2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》，同意将原项目“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目/北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及北方芯能半导体有限公司电子大宗气站项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。

本次变更事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目经公司2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会批准，主要用于新产品的研发及生产、新生产基地建设、并购及补充营运资金等。原项目计划总投资额为60,142.84万元，拟使用募集资金金额为60,000.00万元，具体项目投资额及构成如下：

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	新产能项目	3,300.00	5.49
2	新生产基地项目	37,426.00	62.02
3	并购项目	10,000.00	16.63
4	补充营运资金	9,000.00	14.96
5	项目总投入合计	60,142.84	100.00

截至2022年7月15日，原项目已使用募集资金25,836.20万元，结余募集资金34,163.80万元，均存放于公司在中国银行、光大银行及中信银行苏州本部支行开立的募集资金专户中。

原项目募集资金使用及结余情况如下：

序号	投资类别	已投入募集资金	尚需支付尾款	结余募集资金
1	新产能投资项目	1,210.20	0.00	2,094.00
2	新生产基地项目	6,403.43	12,735.00	32,370.00
3	并购项目	10,000.00	0.00	10,000.00
4	补充营运资金	9,000.00	0.00	9,000.00
5	项目总投入合计	26,703.63	12,735.00	34,163.80

（二）变更的主要原因

原项目的建设主要包

括新产品的研发及生产、新生产基地建设、并购及补充营运资金等，均与公司现有主要业务、核心技术密切相关，符合公司发展战略及发展战

略，是公司现有主要业务、核心技术发展的支撑与保障。

截至2021年12月31日，原项目“新产品的研发及生产”、“新生产基地建设”、“高纯三氟化氯”、“高纯三氟化硼”、“液态有机氟化氢技术”、“改性碳纤维脱硫技术”均已形成工艺并结项。

“新生产基地建设”中“年产10吨高纯三氟化氯”、“高纯三氟化硼”、“液态有机氟化氢技术”、“改性碳纤维脱硫技术”均已形成工艺并结项。

“年产5000吨电子级氟化氢”、“年产5000吨电子级液氟项目”因所在化工园区尚未匹配具体地址，项目尚未开展。

综上，公司拟将募集资金投资项目之一的“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目/北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯能半导体有限公司电子大宗气站项目”。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。

本次变更事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、变更募集资金投资项目的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目经公司2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会批准，主要用于新产品的研

发及生产、新生产基地建设、并购及补充营运资金等。原项目计划总投资额为60,142.84万元，拟使用募集资金

金额为60,000.00万元，具体项目投资额及构成如下：

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	建设投资	18,000.00	94.74
1.1	公用工程	6,900.00	31.05
1.1.1	建筑工程费	4,400.00	23.10
1.1.2	设备购置费	600.00	3.16
1.1.3	安装工程费	900.00	4.74
1.2	工程建设其他费用	11,800.00	62.21
1.3	基本预备费	300.00	1.68
2	铺底流动资金	1,000.00	5.26
5	项目总投入合计	19,000.00	100.00

项目建设期共计12个月，预计2023年达到使用状态。

2.北方集成电路技术创新中心大宗气站项目

新项目“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”实施主体北京金宏电子材料有限公司（以下简称“北京金宏”）为公司全资子公司，成立于2021年12月08日，注册资本6,000.00万元人民币，主要为北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司提供氟气（GNE2/PtO2）、氯气（PtO2/IC2）、氩气（PA）、氮气（N2）、液态有机氟化氢（POC2）、压缩空气（CDA）、仪表空气（IA）及高压压缩空气（HPDCA）、高纯压缩空气（XCDA）等电子大宗气体。

新项目“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”总占地面积1887.84平方米，地上建筑面积944.56平方米，项目内容包括建设综合厂房（含空压机房、纯化间、配电室、消防泵房等）、氯气纯化间和供气系统以及露天储罐区。

新项目“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”总投资25,000.00万元，其中，建设投资24,300万元，铺底流动资金700万元，具体项目投资额及构成如下：

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	建设投资	24,300	97.20
1.1	公用工程	23,300	93.20
1.1.1	建筑工程费	4,000	23.10
1.1.2	设备购置费	600	3.16
1.1.3	安装工程费	900	4.74
1.2	工程建设其他费用	4,300	17.20
1.3	基本预备费	500	2.00
2	铺底流动资金	700	2.80
5	项目总投入合计	25,000.00	100.00

项目建设期共计12个月，预计2023年达到使用状态。

3.广东芯能半导体有限公司电子大宗气站项目

新项目“广东芯能半导体有限公司电子大宗气站项目”实施主体广州金宏电子材料有限公司（以下简称“广州金宏”）为公司全资子公司，成立于2020年01月19日，注册资本18,000.00万元人民币，为广州芯能半导体有限公司电子大宗气站项目提供氟气（GNE2/PtO2）、氯气（PtO2/IC2）、高纯氩气（PA）、氮气（N2）、液态有机氟化氢（POC2）、压缩空气（CDA）、仪表空气（IA）及高压压缩空气（HPDCA）、高纯压缩空气（XCDA）等电子大宗气体。

新项目“广东芯能半导体有限公司电子大宗气站项目”拟租给广东芯能半导体有限公司“内土地3493.01平方米，建设高纯氟气3000Nm3/h、高纯氩气1500Nm3/h、高纯氯气400Nm3/h、高纯氮气108Nm3/h、高纯氩气108Nm3/h、高纯氯气18Nm3/h、高纯压缩空气1000Nm3/h”大宗气站一座。

新项目“广东芯能半导体有限公司电子大宗气站项目”总投资16,000.00万元，其中，建设投资13,786.00万元，铺底流动资金1,240.00万元。具体项目投资额及构成如下：

序号	投资类别	投资金额(万元)	投资占比(%)
1	建设投资	13,786.00	91.91
1.1	公用工程	12,980.00	86.97
1.1.1	建筑工程费	1,000.00	6.67
1.1.2	设备购置费	2,698.00	19.24
1.1.3	安装工程费	400.00	2.67
1.2	工程建设其他费用	400.00	2.67
1.3	基本预备费	400.00	2.67
2	铺底流动资金	1,240.00	8.09
5	项目总投入合计	15,000.00	100.00

项目建设期共计12个月，预计2023年达到使用状态。

综上，新项目总投资合计59,000.00万元，拟使用募集资金34,163.80万元，项目投资总额与募集资金使用金额之间的差额公司将自项目资本金中予以归还。

新项目是公司提高市场竞争力和可持续发展的重要战略举措，有着非常优越的技术优势和市场条件。

1.新项目的建设，有助于公司抢占市场先机，提升市场占有率为。

随着半导体集成电路技术的发展，对电子气体的纯度和质量都有了越来越高的要求。电子气体的纯度提升一个数量级，对下游集成电路行业都会产生巨大影响。2014年国家发布了《国家集成电路产业振兴规划》，并设立了集成电路产业投资基金，规划要求，国家集成电路产业投资基金将逐年增加将保持在20%左右，预计2020年达到8700亿元。若半导体电子气体保持同样稳定的增长，国内半导体电子气体市场将在2020年翻番。

2.新项目的建设，是公司战略布局的需要，符合公司未来发展方向。

公司坚持技术创新战略，以科技为主导，定位为综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，助力公司成为国内供气电子大宗气体的供应商，将大力推进该领域国产替代。

新项目的建设，有助于公司提升产品竞争力，突破我国在半导体产业链中的技术瓶颈，提升公司整体股东利益的。

新项目的建设，将逐步提升公司的竞争优势，为公司战略布局的重又一环，符合公司未来发展方

向。

3.本项目的建设，符合相关产业政策的要求。

新项目采用国内自主研发、先进的技术和设备，项目符合国家有关产业政策，并满足国家和地方的环保要求，充分利用当地资源优势、生产成本低、项目市场稳定，保证了项目的效益。具有较强的市场竞争力，对于推动当地资源优势经济持续发展、环境治理保护等方面都具有重要意义。

（三）募集资金管理计划

相关工作程序完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全，健全金宏、北京金宏及广州金宏将开立募集资金专用账户，并与公司以及存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户四方监管协议，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金。